

2010年3月期 中間決算説明会

2009年11月2日

東京エレクトロン デバイス株式会社



連結業績

(単位:百万円)

	2009年3月期		2010年3月期		増減率 (%)
	中間	百分比%	中間	百分比%	
売上高	52,432	100.0	40,923	100.0	21.9
売上総利益	8,336	15.9	6,293	15.4	24.5
営業利益	1,593	3.0	615	1.5	61.4
経常利益	1,508	2.9	620	1.5	58.8
当期純利益	731	1.4	308	0.8	57.8
1株当たり中間純利益	6,904.91円		2,912.61円		
R O E	6.7 %		2.9%		
従業員数	830人		845人		

連結資産

(単位:百万円)

科目	2009年 3月31日現在	2009年 9月30日現在	増減額
現預金	1,245	1,151	93
受取手形・売掛金	15,479	19,268	3,788
たな卸資産	15,879	16,534	654
その他流動資産	3,250	2,560	689
有形固定資産	1,334	1,239	95
無形固定資産	643	536	107
投資その他の資産	2,846	2,764	81
資産計	40,680	44,055	3,375

連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2009年 3月31日現在	2009年 9月30日現在	増減額
買掛金	6,706	7,658	951
短期借入金	3,806	5,474	1,668
その他流動負債	3,969	4,531	562
固定負債	4,784	4,944	159
負債計	19,266	22,609	3,342
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	13,351	13,310	41
評価・換算差額等	79	5	74
純資産計	21,413	21,446	33
負債・純資産計	40,680	44,055	3,375

連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2009年3月期 中間	2010年3月期 中間	増減額
営業キャッシュ・フロー	2,159	1,364	3,523
投資キャッシュ・フロー	499	60	438
財務キャッシュ・フロー	1,687	1,336	3,024
現金及び現金同等物 中間期末残高	1,420	1,151	269

セグメント別 連結売上高

(単位:百万円)

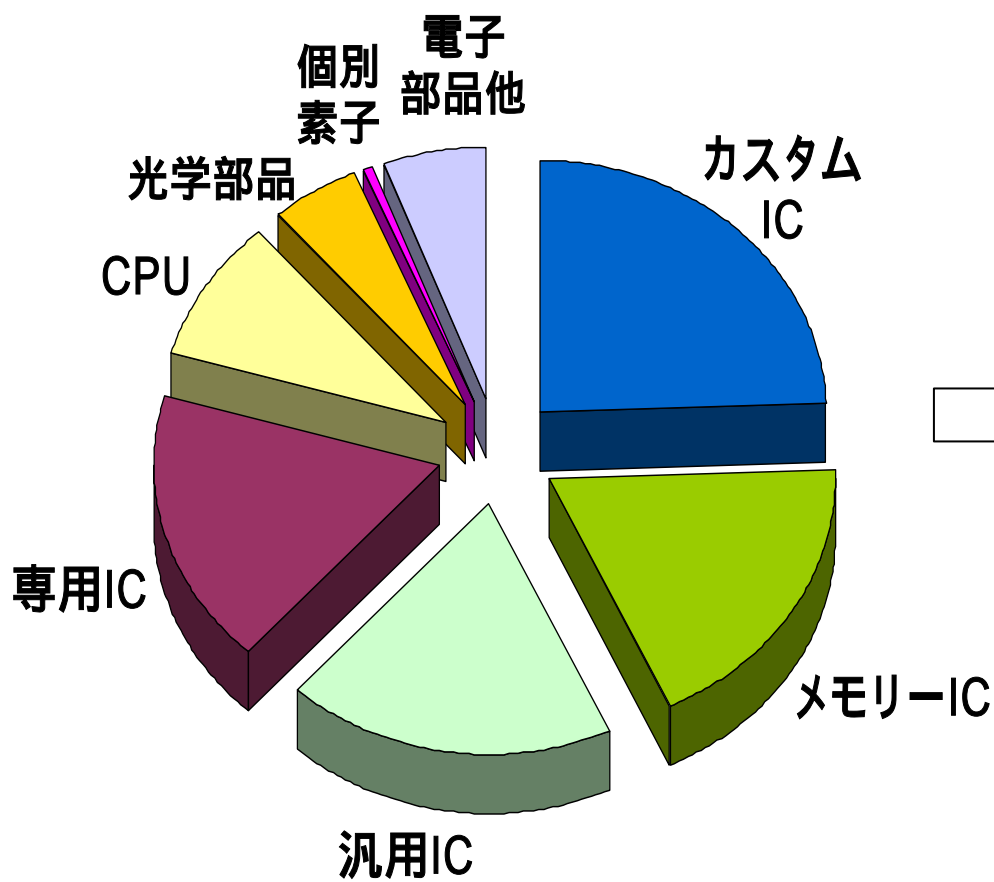
セグメント	2009年3月期 中間		2010年3月期 中間		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体及び電子デバイス事業	42,312	80.7	32,661	79.8	22.8
コンピュータシステム関連事業	10,120	19.3	8,262	20.2	18.4
合 計	52,432	100.0	40,923	100.0	21.9

半導体及び電子デバイス事業

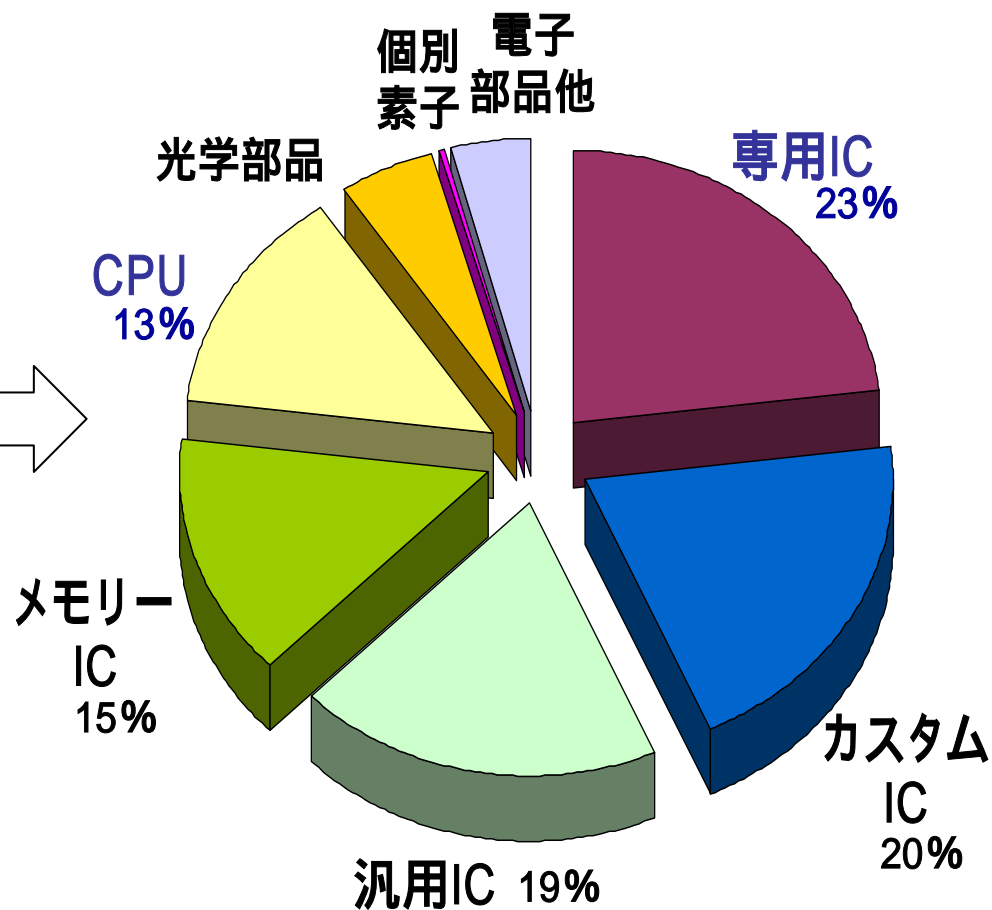


半導体及び電子デバイス事業 品目別 売上構成

< 2009年3月期中間 内訳 >
売上高: 42,312百万円



< 2010年3月期中間 内訳 >
売上高: 32,661百万円



* 品目についての説明は、P.28 ~ P.30をご参照ください。

半導体及び電子デバイス事業 品目別 売上増減

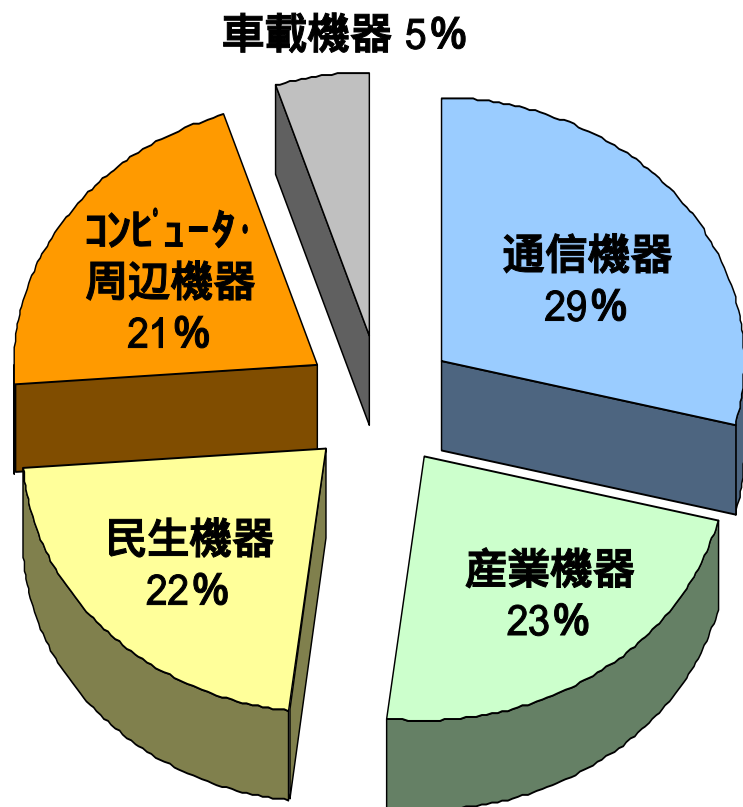
主な品目	主な仕入先	対前年 増減率
専用IC	ビクシス、ビクセルワークス、加ビウム、フリースケール	0.2%
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	36%
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	20%
メモリIC	スパンション、IDT	40%
CPU	フリースケール、富士通、TI	14%

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

用途別 売上構成

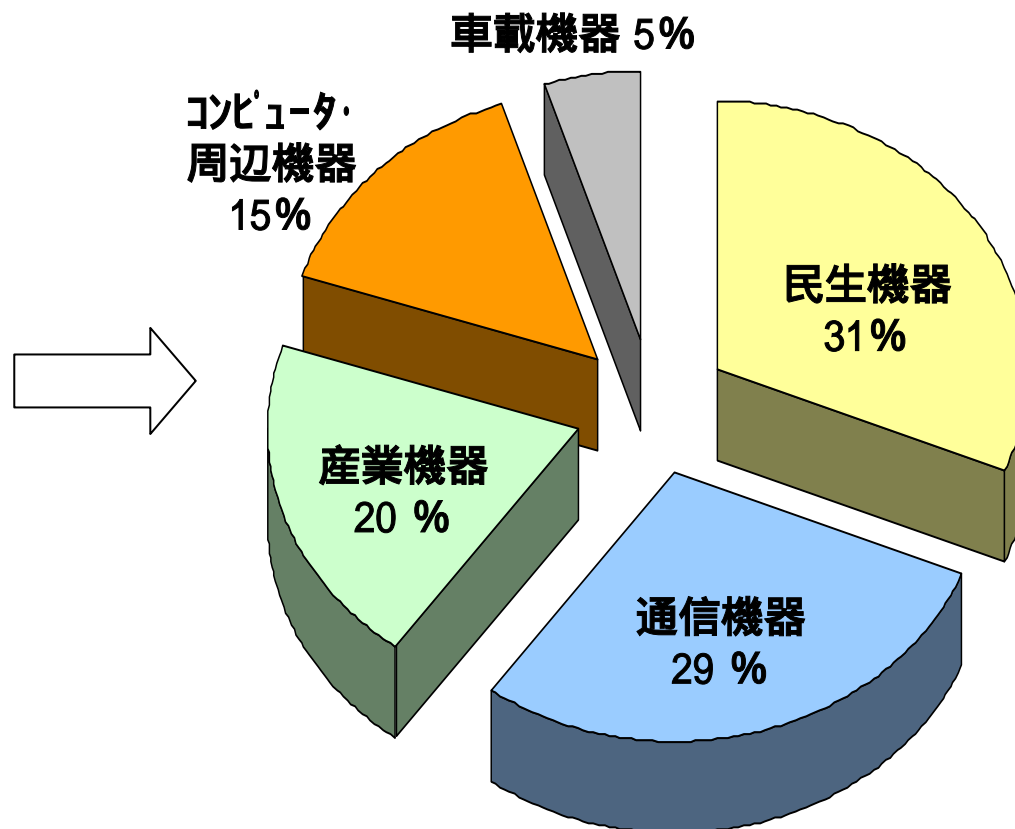
< 2009年3月期中間 内訳 >

売上高: 42,312百万円



< 2010年3月期中間 内訳 >

売上高: 32,661百万円

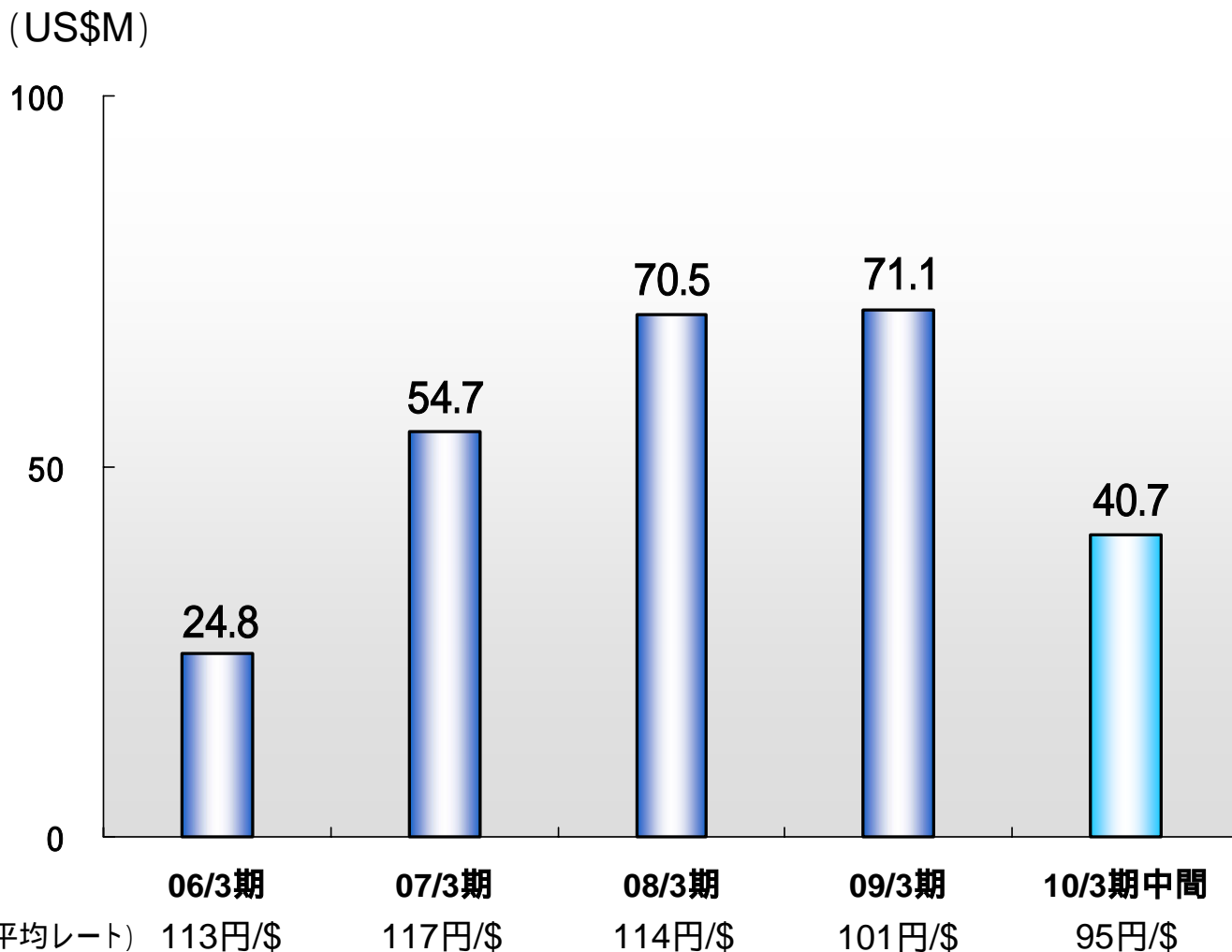


用途別 傾向

用途	主なアプリケーション	主なお客様	当社の傾向
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	パナソニック、シャープ、東芝、ソニー	エコポイント等需要喚起あり、回復傾向
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	パナソニック、富士通、NEC、日立	基地局含むインフラは低調 携帯電話は横ばい
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器、工作機器	東芝、パナソニック、沖、日立	医療機器、放送機器以外の産業機器が低調
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	パナソニック、NEC、日立、富士ゼロックス	複合プリンターは堅調、PC、液晶プロジェクタ等低調
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	パナソニック、アイシン、三菱	カーナビゲーションは、回復傾向

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

[海外連結子会社売上高推移]



[営業拠点]

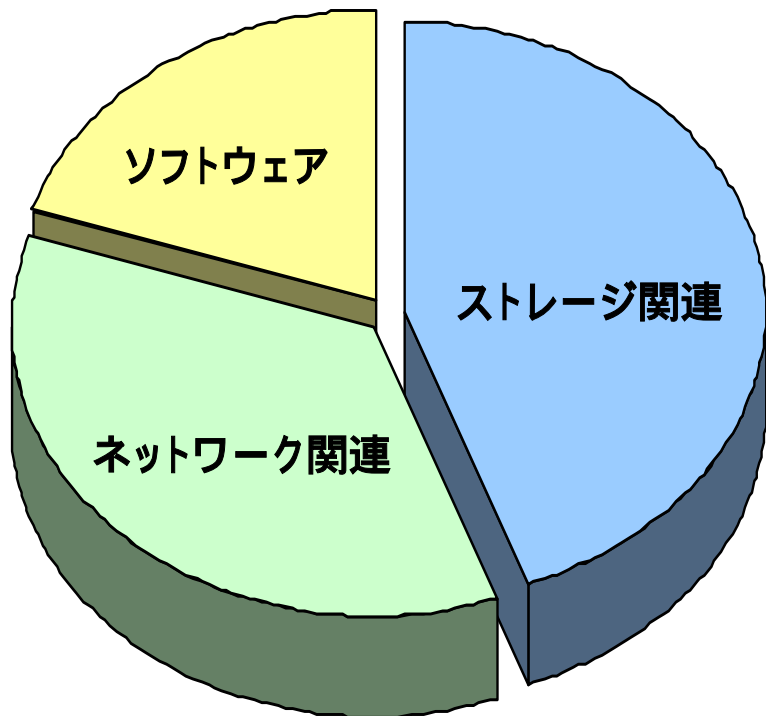
香港、上海、大連、シンガポール



コンピュータシステム関連事業

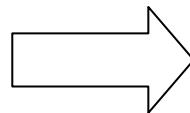
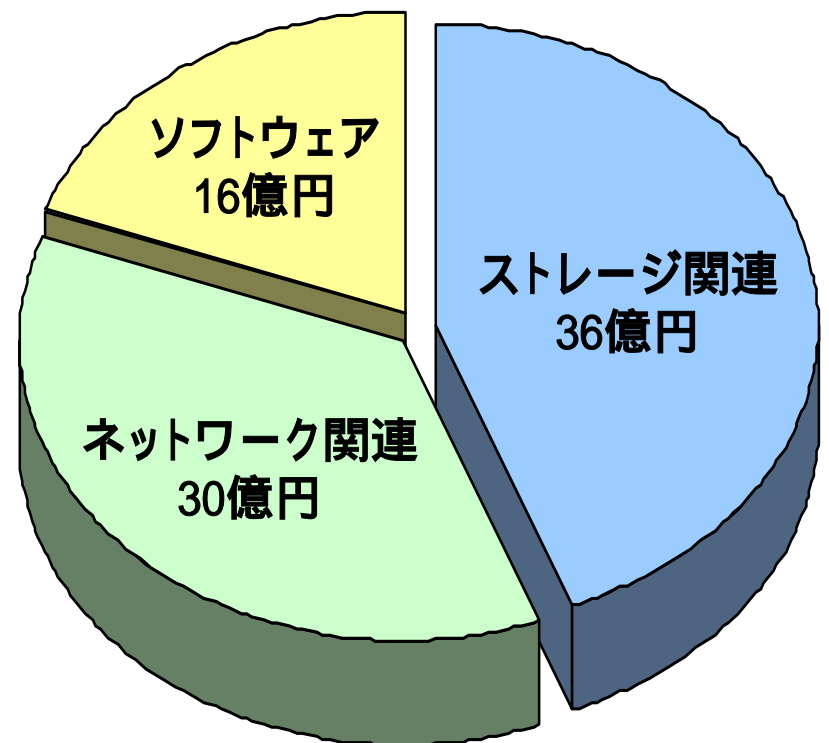
< 2009年3月期中間 内訳 >

売上高: 10,120百万円



< 2010年3月期中間 内訳 >

売上高: 8,262百万円



コンピュータシステム関連事業 品目別売上増減要因

品目	主な仕入先	対前年増減率
ストレージ関連	ブロード	19%
ネットワーク関連	F5ネットワークス	16%
ソフトウェア	マイクロソフト	21%

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

< 主な増減 >

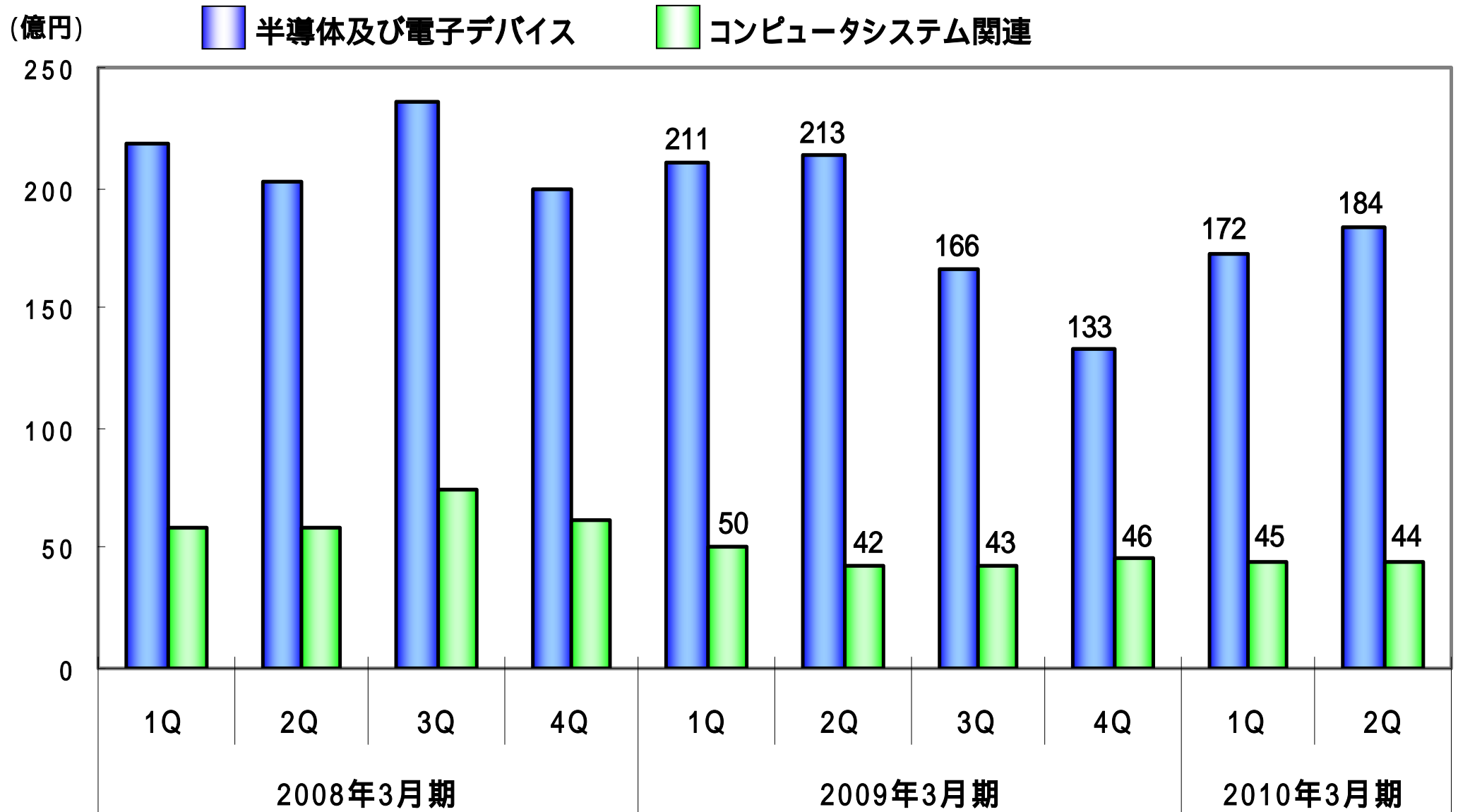
ストレージ関連：企業向けSANスイッチ減少

ネットワーク関連：企業のIT投資抑制の影響を受け減少

ソフトウェア：POS端末向けソフトウェア減少

今期の業績予想について

受注高推移



* 2008年3月期の数値はセグメント区分に組替え修正しております。

当社を取りまく事業環境 予想

< 半導体及び電子デバイス事業 >

- ・ 半導体市場は上期に在庫調整が終了
- ・ 民生機器を中心に回復基調
- ・ 産業機器も一部に底入れ見られ、脱却感あり
- ・ しかし、全体的には回復弱く、不透明感残る状況

< コンピュータシステム関連事業 >

- ・ データセンター等投資継続分野はあるが、引き続き国内IT市場はマイナス成長を想定

2010年3月期 連結業績予想

2009年10月29日発表

(単位:百万円)

	中間実績	下期予想	通期予想	対前年通期 増減額
売上高	40,923	41,077	82,000	12,701
営業利益	615	865	1,480	360
経常利益	620	780	1,400	641
当期純利益	308	472	780	163

セグメント別 連結売上高予想

(単位:百万円)

セグメント	中間実績	下期予想	通期予想	対前年通期 増減額
半導体及び電子デバイス事業	32,661	31,950	64,611	10,369
コンピュータシステム関連事業	8,262	9,127	17,389	2,332
合 計	40,923	41,077	82,000	12,701

2010年3月期の活動方針

1. 利益確保に向けた体質強化

- ・ 管理可能費用のコントロールの徹底

2. 半導体及び電子デバイス事業

- ・ 既存顧客の深堀り及び商権拡大
- ・ 成長分野(環境/セキュリティ)へのプロモーション活動

3. コンピュータシステム関連事業

- ・ 製品別営業からアカウント営業に組織改編
- ・ 製品個々の販売からソリューション営業を強化

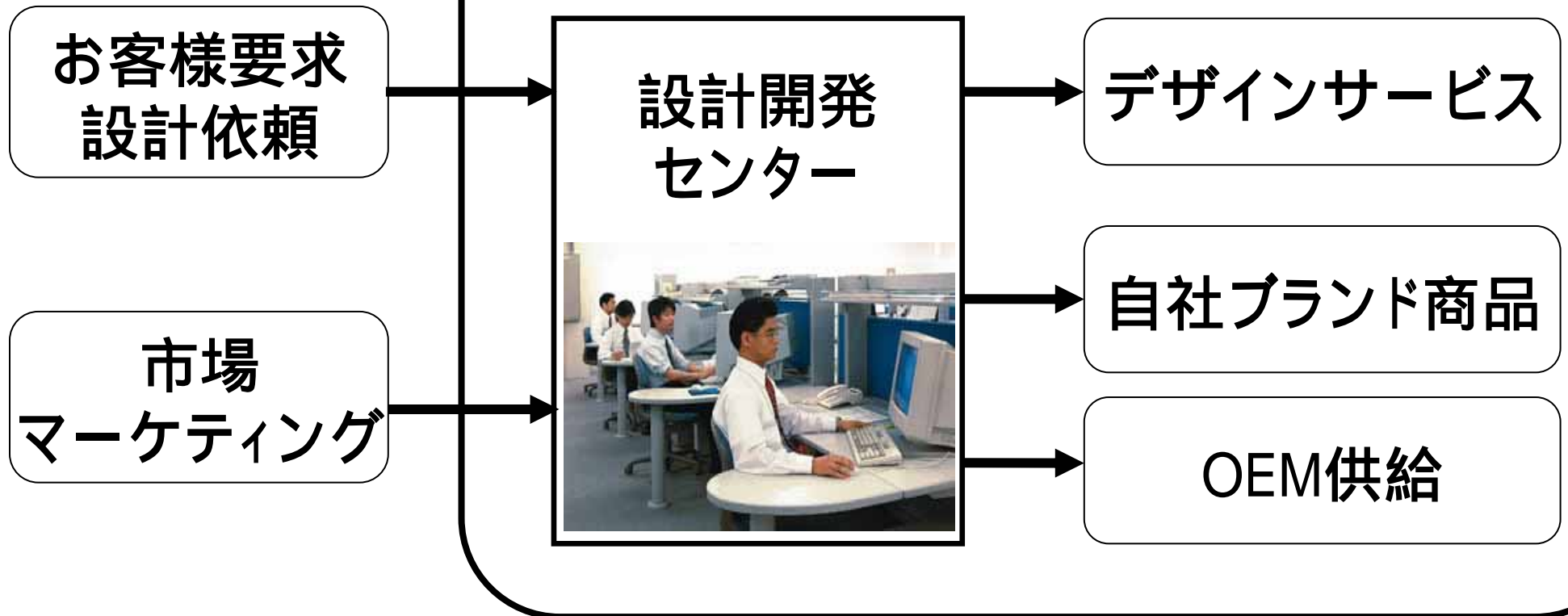
開発ビジネスについて

inrevium

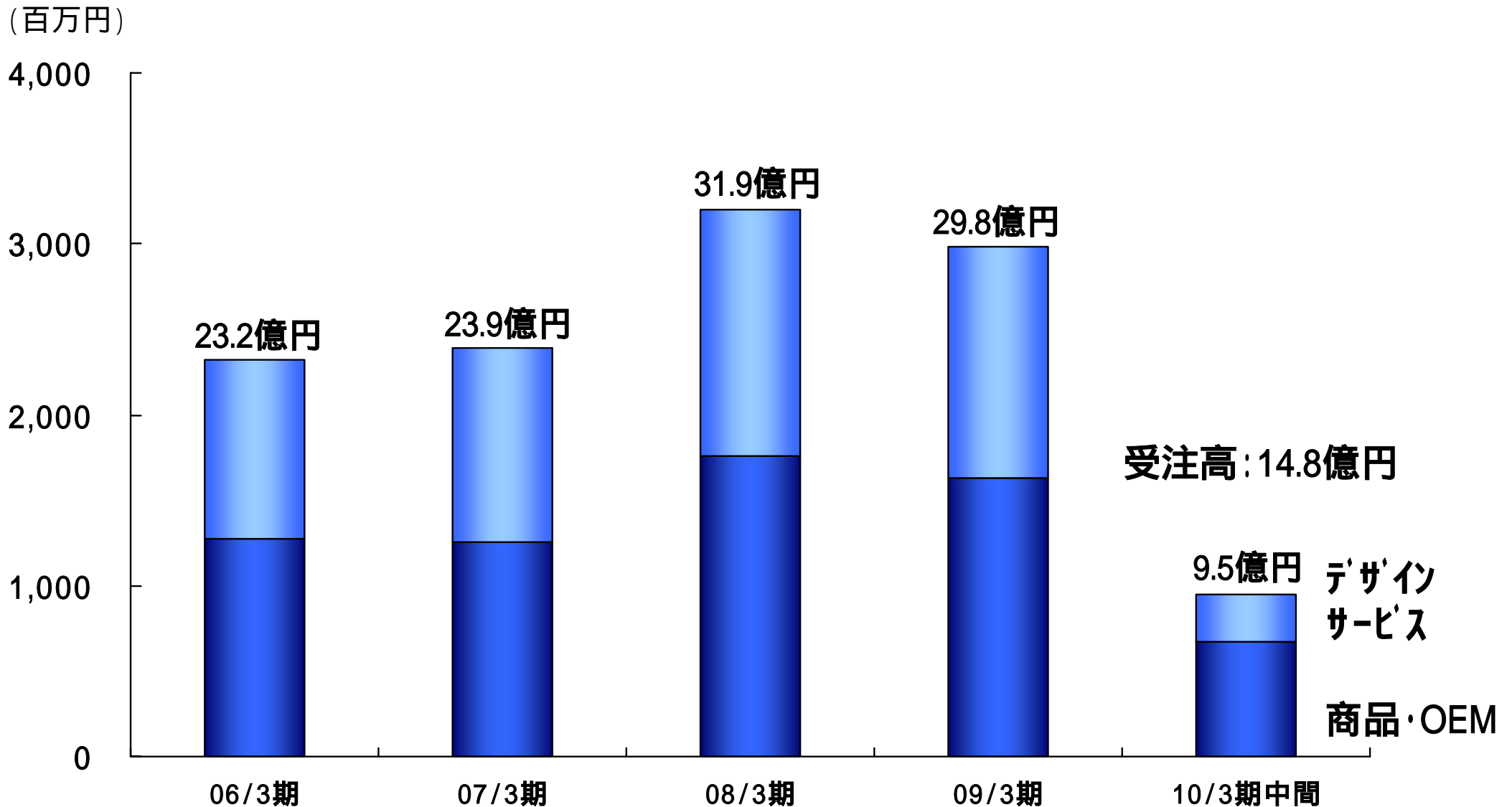
(インレビウム)

開発ビジネス強化への取組み

開発ビジネス (インレビウム ビジネス)



インレビウム売上高推移



インレビウム商品 開発例

FPGA搭載 LSI開発支援用評価ボード

- ・ 高速メモリDDR3を搭載
- ・ 省電力化、省スペース化が求められるLSIの開発に効果
- ・ PCI Express対応ハーフサイズ画像処理ボード
- ・ LSI開発の期間短縮、費用削減に効果
- ・ 量産へ向けたカスタマイズ対応も可能



< 主な応用分野 >
 デジタル民生機器、高速画像機器等



< 主な応用分野 >
 医療機器、画像検査装置等

< 設計受託業務、OEM >

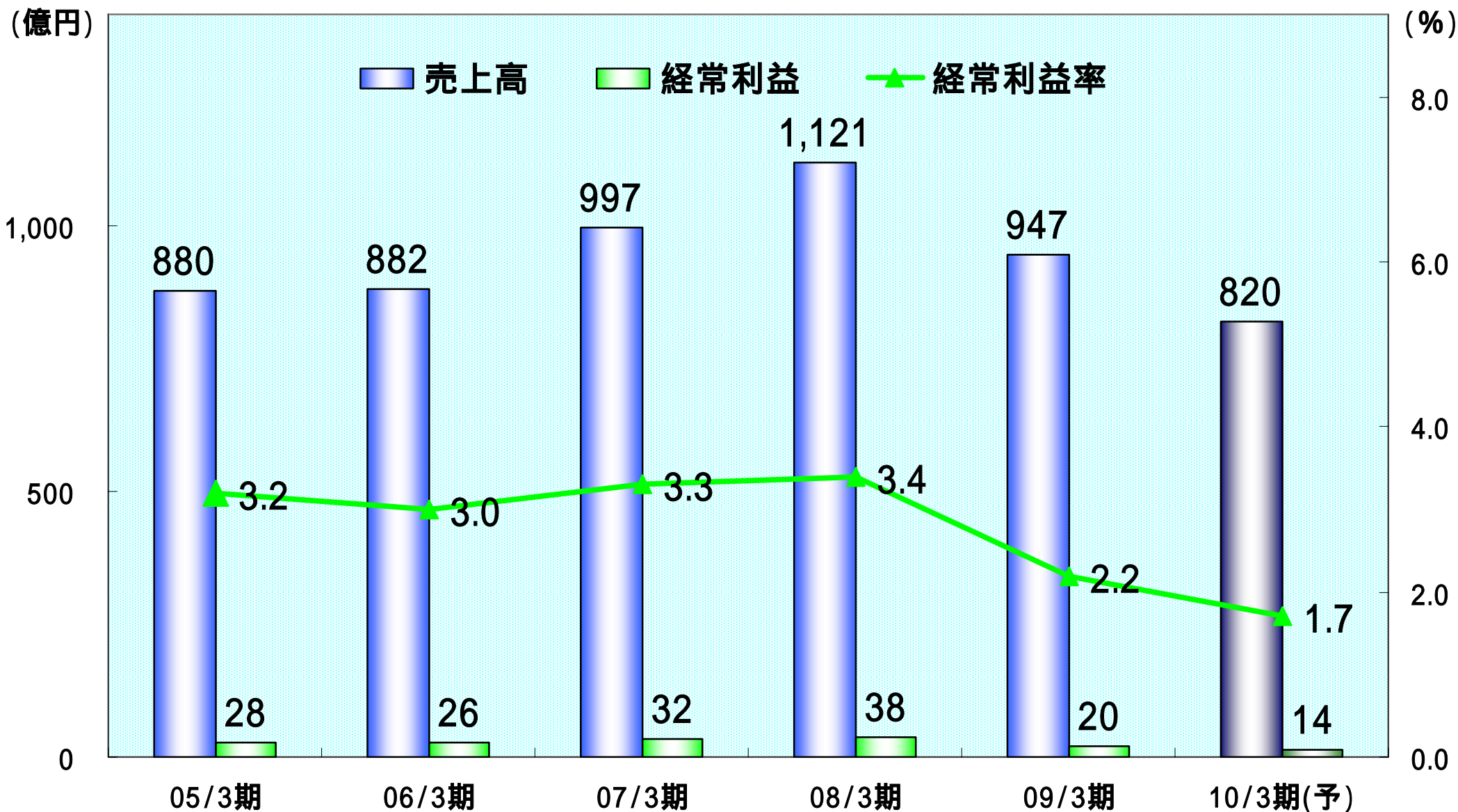
- ・ トップセールスによる営業推進
- ・ 量産供給及び品質体制の強化

< 自社ブランド商品 >

- ・ セキュリティ関連向け商品群の拡充
- ・ FPG A搭載ボードの開発強化

業績推移・計画

参考資料



セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス 事業	専用IC	加'ウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ'社、富士通エレクトロニクス(株)、 インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメージ'社、ピクシシステムズ'社、 ザ'リンク・セミコンダ'クター社、インビ'アム
	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ'イリンクス社、インビ'アム
	汎用IC	リニアテクノロジー'社、オン・セミコンダ'クター社、TI 社
	メモリIC	IDT社、ラムロンインターナショナル社、スパンション社
	CPU	フリースケール・セミコンダ'クタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI 社
	光学部品	アバ'ゴ・テクノロジー'社
	個別素子	オン・セミコンダ'クター社
	電子部品他	コーセル(株)、インビ'アム
コンピュータシステム 関連事業	ストレージ'関連	ブ'ロケード'社、エミュレックス社
	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセ'ージ'社

品目	主な取扱商品	機能
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
メモリIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

ストレージ関連		SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。
ネットワーク関連		インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)企業向けネットワークシステム構築機器。
ソフトウェア		セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。